

# 半导体高温蒸煮老化测试

产品名称	半导体高温蒸煮老化测试
公司名称	深圳市讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 13378656621

## 产品详情

高压蒸煮试验采用高压高湿条件，主要考核塑料封装的半导体集成电路和空封器件等电子器件的综合影响，是用高加速的试验方式评价电子产品耐湿热和密封的能力，常用于产品

开发、质量评估、失效验证。

压蒸煮试验的技术指标包括:大气压力、相对湿度(饱和或非饱和)、温度、 试验时间。

常用于塑料封装的半导体器件、集成电路、密封继电器，密封器件等。

参考标准

JESD22-A100C湿热循环偏压寿命试验